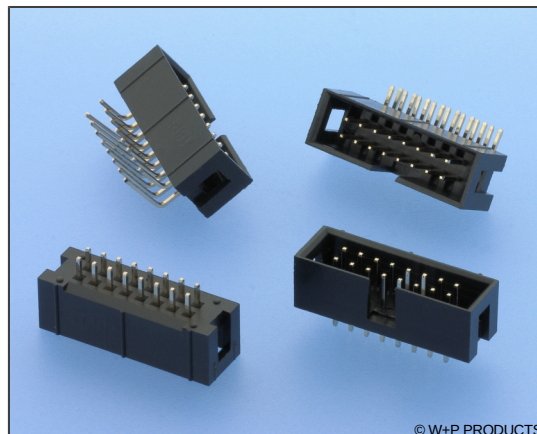
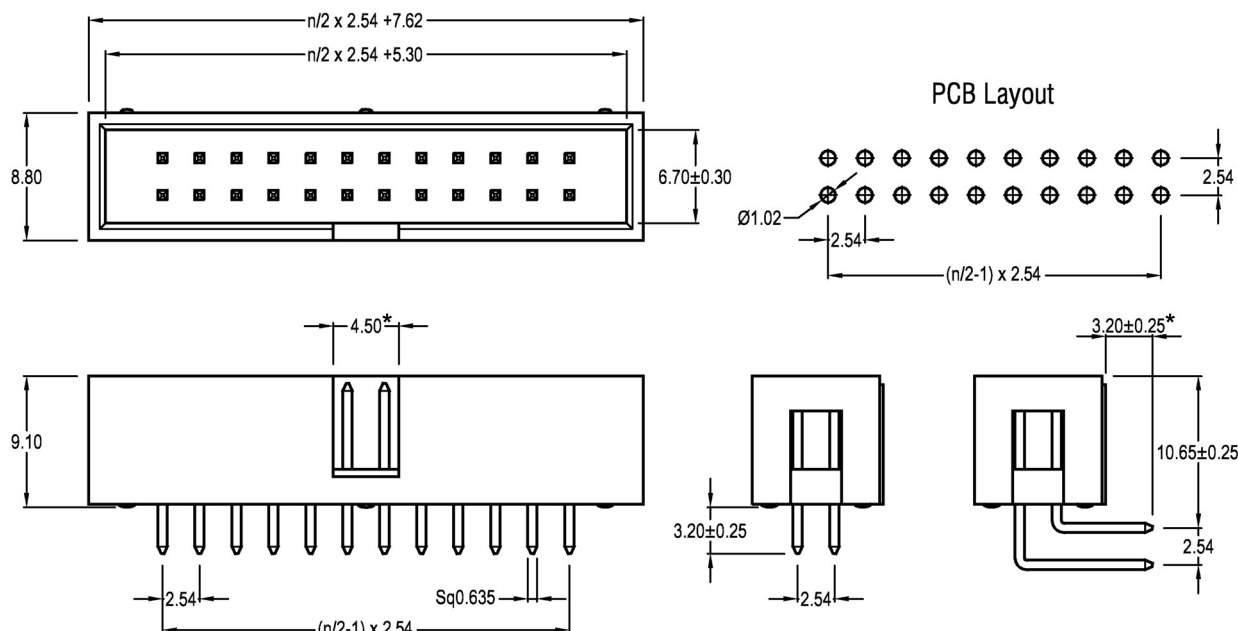


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Withstanding Voltage	500 V AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
Temperature Range	-55 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren (*2)
	(auf Anfrage auch für Reflow-Lötverfahren erhältlich)
Processing	Wave soldering (*2)
	(also available on request for reflow soldering)



© W+P PRODUCTS

 Passende Gegenstecker:
 Compatible Connectors:
141 157B


* 06/08 - grau/grey insulator : opening 4.00mm

* grau/grey insulator : dimension C 2.90±0.30mm

Series	Contacts*	Type*	Plating*	Colour (Optional)*	Material (Optional)*
137	20	1	00	6	HT
	06/08/10/14/16/20 24/26/30/34/40/44 50/60/64	1 Gerade Straight 2 Gewinkelt Right-angled	00 Vergoldet Gold plated 60 Sel. Au / Sn Duplex Plating	[] Standard: schwarz Standard: black 6 Grau Grey	[] Standard: Für Wellenlöten Standard: For wave soldering HT Für Reflow-Löten For reflow soldering

 * Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

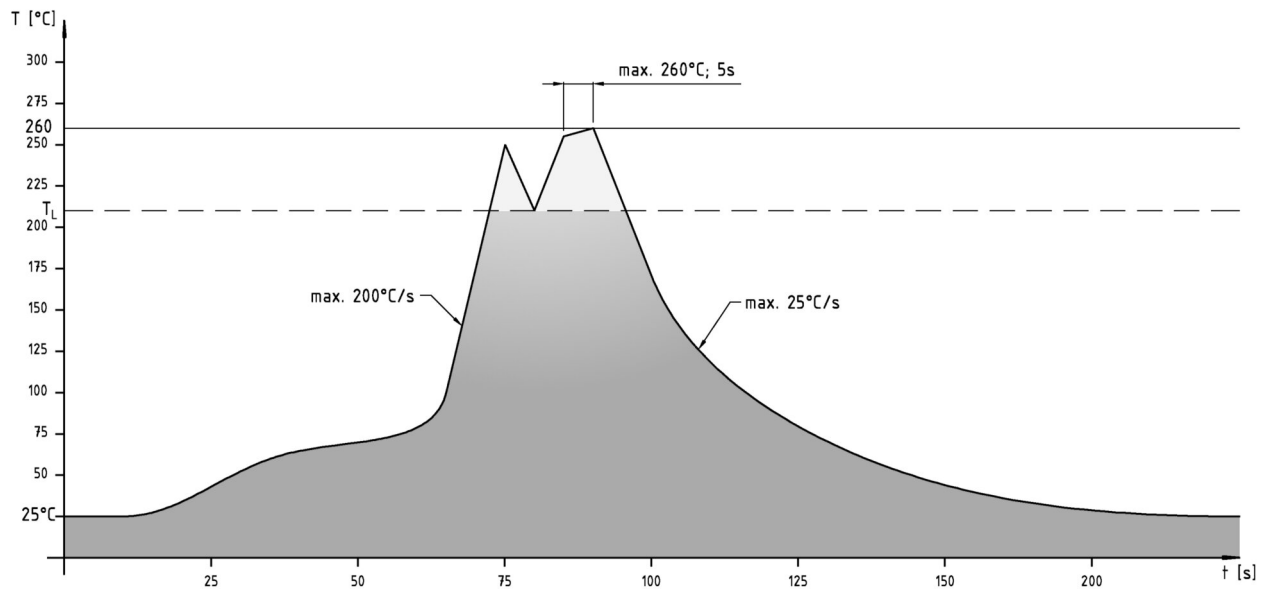
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25 °C - Peak Temp. T_P	max. 8min

